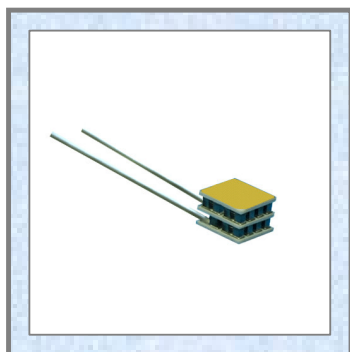


THERMO MODULE DATA

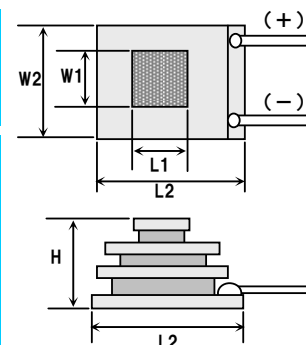
型式 K2M006

RoHS 2002/95/EC Compliant



Th	$\Delta T_{max}(^{\circ}C)$	$I_{max}(A)$	$V_{max}(v)$	$Q_{cmax}(w)$
27°C	94	2.6	1.0	0.7
50°C	106	2.6	1.1	0.8

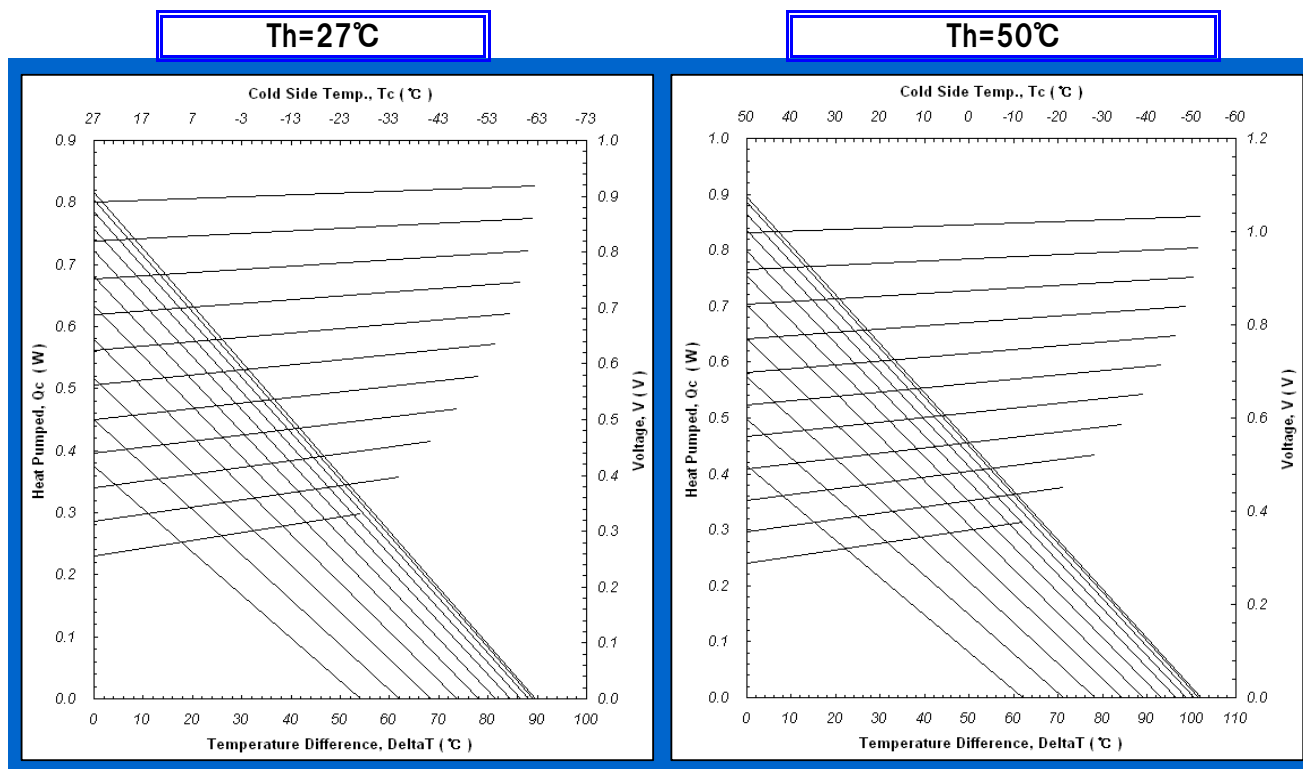
	W1	L1	W2	L2	H
寸法(mm)	4.05	4.05	4.05	4.05	3.00
公差(mm)	± 0.2	± 0.2	± 0.2	± 0.2	± 0.2
上下メタライズ	Cu-Ni-Au				
セラミック材質	アルミナ				
組立半田	SnSb (融点232°C)				



オプション

組立半田	AuSn (融点280°C)
セラミック材質	窒化アルミ、またはアルミナと窒化アルミの組み合わせ
予備半田	InSn(融点117°C)、BiSn(融点138°C)、組立半田AuSnを選定時はSnAgCu(融点217°C)も対応可能

性能特性図



雰囲気	窒素
電流値	$I = 0.8 \sim 2.6 A$ (Step = 0.2 A)

株式会社KELK

www.kelk.co.jp

■本社・工場

〒254-8543 神奈川県平塚市四之宮3-25-1

TEL 0463-22-8724

FAX 0463-22-3692

■素子事業部 技術営業Gr

〒254-8543 神奈川県平塚市四之宮3-25-1

TEL 0463-23-3697

FAX 0463-24-6749

E-mail : sales@kelktech.komatsu.co.jp